



2025年11月11日

各 位

高周波基板用電解銅箔「VSPTM」の生産体制増強 ～台湾・マレーシア両工場における約60億円の投資により1,200t/月体制に増強～

当社(社長 納武士)は、現在台湾工場(台湾銅箔股份有限公司)およびマレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia) Sdn Bhd)にて製造している高周波基板用銅箔「VSPTM」の生産体制について、両工場での生産能力追加増強により、2025年8月20日付ニュースリリース「高周波基板用電解銅箔「VSPTM」の生産体制増強」にて公表しました2026年9月までの840t/月への増強に加え、約60億円の投資を行い2028年9月までに360t/月増の1,200t/月体制とすることをお知らせいたします。

当社の高周波基板用電解銅箔「VSPTM」は、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、サーバー、ルーター、スイッチ等の高性能通信インフラ機器に採用されております。足元はAIインフラ関連向けにHVLP5グレード品が量産フェーズに移行し、ビッグテック各社での採用が進むなど市場での当社VSPTMの需要が急激に増加しており、今後も更なる拡大が期待されます。

このような状況を受け、台湾工場(台湾銅箔股份有限公司)とマレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.)において汎用銅箔の現有設備の追加転用と現有設備でのさらなる生産性改善及び表面処理機の新設を図り、前回公表の2026年9月までの840t/月への増強に加え、約60億円の投資により2027年9月までに1,000t/月体制、2028年9月までに1,200t/月体制へと段階的に増強いたします。また今回の投資はROIC経営を進めている当社の銅箔事業における投資基準を十分満足する計画となります。

これらの施策により生産能力は増加いたしますが、今後もさらなる需要拡大に応じた増強も視野に入れ、旺盛な需要に十分対応してまいります。

当社は、パーソンズである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル(持続可能)な社会作りに貢献してまいります。

■VSP™ 生産能力(ご参考)

単位:t/月	2025年11月 現在	2026年3月	2026年9月	2027年9月	2028年9月
台湾工場	560	600	720	760	860
マレーシア工場	60	120	120	240	340
計	620	720	840	1,000	1,200

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL :03-5437-8028 E-mail:PR@mitsui-kinzoku.com



汎用銅箔



VSP™

写真 アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP™は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴



台湾工場

(台湾銅箔股份有限公司)



マレーシア工場

(Mitsui Copper Foil (Malaysia) Sdn Bhd)

写真 増産する台湾工場とマレーシア工場

(ご参考)

VSP™の主な用途 :

通信インフラ機器（サーバー、スイッチ、ルーター、基地局など）などの高周波基板用銅箔